# АКУСТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: ПЕРЕХОД ОТ ОБЪЕМНЫХ МАТЕРИАЛОВ К НАНОСТРУКТУРАМ

#### Денис НИКА

## Кафедра теоретической физики Лаборатория «Физика и инженерия наноматериалов и синергетика» им. Е. Покатилова.

În acest articol autorul prezintă o descriere succintă a conceptului de inginerie fononică în structurile nanodimensionale. Acest concept constă în dirijarea orientată a spectrului energetic fononic al nanostructurilor pentru schimbarea conductibilității lor electronice sau termice. De asemenea, este descrisă o abordare teoretică pentru modelarea conductibilității termice la nivel "nano". O atenție deosebită în contextul conductibilității termice a structurilor nanodimensionale este acordată rolului dispersiei fononilor pe suprafață.

In the paper the author presents brief description of the nanoscale *phonon engineering* concept, i.e. concept of a tuning the phonon energy spectrum in order to change the ability of nanostructures to conduct heat or electric current. He also reviews a theoretical approach for thermal conductivity modeling at nanoscale. A special attention is given to the role of phonon boundary scattering on the thermal conductivity of nanostructures.

#### Введение

Тепловой транспорт в наноразмерных структурах широко исследуется по всему миру [1-8]. Одновременно ведется теоретический и экспериментальный поиск как новых типов наноразмерных структур с высокой теплопроводностью [1-2] для применений в микро- и наноэлектронике в качестве эффективных теплоотводящих материалов, так и с низкой теплопроводностью для термоэлектрических применений [3-8]. Коэффициент термоэлектрической добротности "figure of merit"  $ZT = S^2 \sigma T / (\kappa_{ph} + \kappa_{el})$ 

содержит в знаменателе решеточную и электронную теплопроводность (  $\kappa_{ph}$  и  $\kappa_{el}$  соответственно),

поэтому уменьшение теплопроводности при условии сохранения хороших электропроводящих свойств (электропроводности  $\sigma$  и коэффициента Зеебека S) позволяет повысить ZT в широком диапазоне температур T.

Объемный кремний является плохим термоэлектрическим материалом с ZT ~ 0,001 при комнатной температуре [9]. В то же самое время кремниевые нанонити с диаметром в несколько десятков нанометров в настоящее время рассматриваются перспективными для термоэлектрических применений [5-7]. В недавно опубликованных экспериментальных работах [6-7] показано, что в ультратонких кремниевых нанонитях и сверхрешетках из нанонитей с неровными (шероховатыми) краями можно достичь  $ZT \sim 0,3 - 0,6$  при комнатной температуре благодаря пятидесятикратному падению решеточной теплопроводности. Уменьшение решеточной теплопроводности в этих структурах происходит за счет модификации энергетического спектра фононов (по сравнению с объемным случаем) и сильного рассеяния фононов на поверхности нанонитей.

# Фононы в объемных полупроводниковых материалах

В умеренно-легированных объемных полупроводниковых материалах основными переносчиками тепла являются кванты колебаний кристаллической решетки – фононы. Фононная (решеточная) теплопроводность определяется как [10]:

$$\kappa = \sum_{j} \int C_{j}(\omega) \upsilon_{j}^{2}(\omega) \tau_{j}(\omega) d\omega, \qquad (1)$$

где *j* обозначает поляризацию фононной ветви,  $\upsilon_j = d\omega_j / dq$  – это групповая скорость ветви *j*,  $\tau_j$  – это полное время рассеяния фонона и  $C_j$  –теплоемкость ветви *j*. В объёмных полупроводниках акустические фононы могут быть трех поляризаций: одной поперечной (LA) и двух продольных (TA), а  $\upsilon_j$  обычно заменяют средней продольной или поперечной скоростью звука. Важной величиной, опреде-

# STUDIA UNIVERSITATIS

Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 2011, nr.7(47)

ляющей решеточную теплопроводность, является полное время рассеяния фонона  $\tau_j$ , связанное со средней длиной свободного пробега (СДСП) фонона формулой  $\Lambda_j = \tau_j \upsilon_j$ . В приближении времени релаксации различные механизмы, ограничивающие  $\Lambda_j$ , являются аддитивными. В объемных полупроводниках к таким механизмам обычно относится рассеяние фононов на фононах, на несовершенствах кристаллической решетки (вакансии, точечные дефекты, дислокации) и электронах проводимости [10-11]. При низких температурах фононы слабо рассеиваются другими фононами и доминирующим является рассеяние на дефектах или электронах. Рост температуры усиливает фонон-фононное рассеяние, которое при высоких температурах становится основным механизмом, ограничивающим  $\Lambda_j$  и  $\kappa$ .

#### Фононы в наноразмерных структурах

В наноразмерных структурах появляется дополнительное рассеяние фононов – на поверхности наноструктуры. Это рассеяние обычно рассчитывают, используя следующую формулу [10]:

$$\frac{1}{\tau_{B_j}} = \frac{\nu_j}{D} \frac{1-p}{1+p},$$
(2)

где D – размер наноструктуры (толщина), а p – параметр, отвечающий за силу рассеяния на поверхности. Когда  $D > \Lambda_j$ , поверхностное рассеяние является слабым по сравнению с другими видами рассеяния и фононы в наноструктуре ведут себя подобно фононам в объемном материале. Принципиально другая ситуация возникает, когда  $D < \Lambda_j$ . В этом случае поверхностное рассеяние фононов становится важным механизмом рассеяния и тепловые свойства наноструктуры начинают сильно зависеть от D и качества поверхности. Более того, в наноструктурах с D в несколько десятков нанометров начинает проявляться конфайнмент акустических фононов, благодаря чему фононные ветви квантуются и про-исходит сильная модификация фононного энергетического спектра [12-15]. Ввиду отражения от внешних поверхностей структуры фононные моды гибридизируются и перестают быть чисто продольными или чисто поперечными, а групповые скорости фононов уменьшаются по сравнению с объемными материалами.



**Рис.1.** Зависимость энергии (а) и групповых скоростей (б) акустических фононов от волнового числа в кремниевом слое толщиной в 3,36 нм.

На рис.1 проиллюстрировано квантование фононного спектра и уменьшение групповой скорости в кремниевом слое толщиной в 3,36 нм. Дисперсии энергии фононов, представленные на рис.1, получены в рамках динамической "Face-centered cubic cell" модели колебаний кристаллической решетки [8,14]. Как явствует из рисунка 1(б), групповые скорости всех фононных мод меньше, чем продольная скорость звука в объемном кремнии  $v_l = 8,44$  км/с и практически для всех значений q они меньше, чем поперечная скорость звука  $v_t = 5,84$  км/с. Отметим, что энергии и групповые скорости фононов в нано-

структурах сильно зависят от фононной моды (s, q), где *s* обозначает номер фононной ветви, а q – это фононный волновой вектор. Зависимость энергии фонона от волнового вектора имеет выраженный нелинейный характер, поэтому в наноструктурах замена реального закона дисперсии линейной зависимостью от *q* лишена физического смысла.

Теплопроводность квази-2D и 1D наноструктур  $\kappa_{2D}$  и  $\kappa_{1D}$ , выведенная с учетом плотности фононных состояний, имеет вид [8,14]:

$$\kappa_{2D} = \frac{1}{4\pi k_B T^2 d} \sum_{\alpha,s} \int_{0}^{q_{\text{max}}} \left( \hbar \omega_s^{\alpha} \left( q \right) v_s^{\alpha} \left( \omega(q) \right) \right)^2 \tau_{s,tot}^{\alpha} \left( \omega(q) \right) \frac{\exp\left(\frac{\hbar \omega_s^{\alpha} \left( q \right)}{k_B T}\right)}{\left( \exp\left(\frac{\hbar \omega_s^{\alpha} \left( q \right)}{k_B T}\right) - 1 \right)^2} q dq, \tag{3}$$

$$\kappa_{1D} = \frac{1}{2\pi k_B T^2 d_1 d_2} \sum_{\alpha,s} \int_{0}^{q_{\text{max}}} \left( \hbar \omega_s^{\alpha} \left( q \right) v_s^{\alpha} \left( \omega(q) \right) \right)^2 \tau_{s,tot}^{\alpha} \left( \omega(q) \right) \frac{\exp\left(\frac{\hbar \omega_s^{\alpha} \left( q \right)}{k_B T}\right)}{\left( \exp\left(\frac{\hbar \omega_s^{\alpha} \left( q \right)}{k_B T} \right) - 1 \right)^2} dq, \tag{4}$$

где  $k_B$  – это постоянная Больцмана, d – толщина нанослоя,  $d_1$  и  $d_2$  – размеры поперечного сечения нанонити,  $\tau_{s,tot}^{\alpha}$  – полное время рассеяния фонона,  $\alpha$  –поляризация фононной ветви в нанослое или нанонити. Полное время рассеяния фонона определяется формулой:

$$1/\tau_{tot,s}(q) = 1/\tau_{U,s}(q) + 1/\tau_{imp,s}(q) + 1/\tau_{B,s}(q).$$
(5)

В формуле (5)  $\tau_{U,s}$  – это время рассеяния в трехфононных Umklapp–процессах [16-17],  $\tau_{imp,s}$  – это время рассеяния на примесях [16-17]:

$$\frac{1}{\tau_{U,s}(q)} = B(\omega_s(q))^2 T \exp(-C/T), \qquad (6)$$

$$\frac{1}{\tau_{imp,s}(q)} = A(\omega_s(q))^4.$$
<sup>(7)</sup>

Константы *A*, *B* и *C* обычно определяются из сравнения с экспериментальными данными [17]. Время поверхностного рассеяния фононов  $\tau_{B,s}$  в случае нанослоя обычно модулируется формулой (2), а в случае прямоугольной нанонити имеет вид [8]:

$$\frac{1}{\tau_{B,s}(q_z)} = \frac{1-p}{1+p} \frac{|\upsilon_s(q_z)|}{2} \left(\frac{1}{d_x} + \frac{1}{d_y}\right).$$
(8)

Учет в наноструктурах только Umklapp–рассеяния ( $\tau_{tot,s} = \tau_{U,s}$ ) ведет к расходимости интеграла теплопроводности (3-4) в 1D или 2D. Физически это связано с ослаблением Umklapp-рассеяния фононных мод при уменьшении их энергии. В результате, средняя длина свободного пробега длинноволнового фонона бесконечно возрастает. Такого эффекта нет в объемном случае (3D), так как уменьшение трехмерной плотности состояний в 3D компенсирует увеличение СДСП фонона при уменьшении его энергии. Для устранения расходимости в формулах (4-5) при расчете теплопроводности в наноструктурах необходимо либо включать дополнительные механизмы рассеяния длинноволновых фононов (такие, как, например, рассеяние на поверхности наноструктуры [18]), либо учитывать рассеяния фононов в многофононных Normal или Umklapp-процессах [19].

#### Фононная инженерия: результаты и перспективы

Концепция фононной инженерии [12] в наноструктурах заключается в целенаправленном изменении их электропроводящих и теплопроводящих свойств путем изменения их фононных свойств. Однородные

# STUDIA UNIVERSITATIS

Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 2011, nr.7(47)

слои и нанонити позволяют осуществлять инженерию фононов за счёт изменения размеров структуры или качества внешних поверхностей. Композитные многослойные структуры, составленные из слоев с различными фононными свойствами, с этой точки зрения выглядят более перспективными. В таких структурах возникают общие гибридизированные фононные моды, которые могут проявлять как фононные свойства отдельных слоев, так и свойства, усредненные между фононными свойствами различных слоев. Меняя как толщины, так и материал входящих слоев, можно достигать различной степени гибридизации фононных мод и тем самым в широком диапазоне менять теплопроводящие свойства. Теоретическое развитие концепции фононной инженерии в многослойных плоских гетероструктурах и гетеронанонитях представлено в цикле работ [12-15], выполненных физиками-теоретиками Молдавского государственного университета в партнерстве с экспериментаторами из Калифорнийского университета Риверсайд (США). В этих работах продемонстрировано, что в трехслойных плоских гетероструктурах и нанонитях с обкладкой фононные моды подразделяются на три класса: моды внутреннего канала (канальные моды (KM)), обкладочные моды (OM) и общие гетероструктурные моды (ГМ). Колебания атомов в КМ происходят в основном во внутреннем канале структуры, а атомы обкладок остаются практически неподвижными. В ОМ, наоборот, колеблются, в основном, атомы обкладок. В ГМ колеблются и атомы внутреннего канала, и атомы обкладок. На рис.2 показаны колебания всех трех видов на примере трехслойной структуры Si/Ge/Si с толщинами слоев 2,99 нм/ 5,09 нм/ 2,99 нм.

Перераспределение смещений атомов между слоями приводит к подавлению эффекта электронфононного взаимодействия и соответствующему увеличению подвижности электрона в ультратонких кремниевых нанослоях и нанонитях с обкладками из материала с другой скоростью звука [20-21]. На рис.3 показана зависимость отношения подвижности электрона в кремниевом слое толщиной в 2 нм,



**Рис.2.** Смещения атомов в канальной моде (а), обкладочной моде (b) и общей моде (c).

покрытого обкладками из алмаза с толщинами 1 – 15 нм к подвижности кремниевого слоя без обкладки. Покрытие кремния алмазной обкладкой с толщиной в 15 нм увеличивает подвижность электрона в 2 раза при T ~ 300 К и в 10 раз при T ~ 20К. Аналогичный эффект предсказан для кремниевых нанонитей с диаметром в 4 нм, покрытых алмазной оболочкой [21].

Другим перспективным применением концепции фононной инженерии является оптимизация теплового транспорта на наноуровне. Целенаправленно меняя фононные спектры, плотности и групповые скорости фононов, можно увеличивать или уменьшать фононную теплопроводность. На рис.4 показана температурная зависимость теплового потока, рассчитанного на единицу температурного градиента и на толщины гетероструктуры, в кремниевом нанослое толщиной 4,88 нм и в трехслойных гетероструктурах с внутренним каналом из кремния и обкладками из германия, алмаза и пластика. Материал обкладок влияет на тепловой поток в структуре: обкладки с меньшей, чем в кремнии, скоростью звука уменьшают на 15-20 % тепловой поток, в то время как обкладки с большей скоростью звука в 2,5-3 раза увеличивают его.

Качество интерфейсов наноструктуры с  $D << \Lambda_j$  сильно влияет на тепловой транспорт. Увеличение шероховатости поверхности усиливает поверхностное рассеяние фононов и уменьшает теплопроводность.







ис.4. Инженерия фононных потоков в трехслойных гетероструктурах с кремниевым каналом.

На рис. 5 показаны зависимости теплопроводности от температуры в прямоугольной кремниевой нанонити с поперечным сечением 4,2нм×4,2нм для разных значений параметра поверхностного рассеяния p. Параметр p может принимать значения от 0 (предельно плохая поверхность, полное рассеяние фонона) до 1 (идеальная поверхность, нет рассеяния фонона). Как явствует из рис.5, теплопроводность в нанонити с достаточно хорошим качеством поверхности (p = 0,9) примерно в 10 раз меньше, чем теплопроводность объемного кремния  $\kappa = 145$  W/mK при T = 300K. Ухудшая качество поверхности и увеличивая поверхностное рассеяние фононов, можно еще в 5 раз уменьшить значение теплопроводности до 2 W/mK, что примерно в 70 раз меньше, чем в объемном кремнии. Представленные на рис.5 результаты находятся в качественном согласии с экспериментально полученным падением теплопроводности в массивах из шероховатых нанонитей [7].



**Рис.5.** Влияние шероховатости поверхности на теплопроводность кремниевой нанонити с поперечным сечением в 4,2нм×4,2нм.

#### Выводы

Представлено краткое описание основных свойств акустических фононов в объемных материалах и наноструктурах. Проанализирована модификация фононных свойств при переходе от объемных материалов к наноматериалам и описан теоретический подход, широко применяемых для моделиро-

вания теплопроводности в наноструктурах. Особое внимание уделено концепции фононной инженерии и полученным на ее базе результатам по улучшению электропроводящих и теплопроводящих свойств наноструктур.

#### Литература:

- 1. Ghosh S., Bao W., Nika D.L., Subrina S., Pokatilov E.P., Lau C. N. and Balandin A.A. Dimensional crossover of thermal transport in few-layer graphene // Nature Mater., 2010, vol.9, p.555.
- 2. Balandin A.A. Thermal properties of graphene and nanostructured carbon materials // Nature Mater., 2011, vol.10, p.569.
- 3. Balandin A. and Wang K. L. Effect of phonon confinement on the thermoelectric figure of merit of quantum wells // J. Appl. Phys., 1998, vol.84, p.6149.
- 4. Borca-Tasciuc T., Achimov D., Liu W. L., Chen G., Ren H.-W., Lin C.-H. and Pei S. S. Thermal conductivity of InAs/AlSb superlattices // Microscale Thermophys. Eng., 2001, vol.5, p.225.
- Li D., Wu Y., Kim P., Shi L., Yang P. and Majumdar A. Thermal conductivity of individual silicon nanowires // Appl. Phys. Lett, 2003, vol.83, p.2934.
- 6. Boukai A.I. et. al. Silicon nanowires as efficient thermoelectric materials // Nature., 2007, vol.451, p.168.
- Hochbaum A. I. et. al. Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires // Nature, 2008, vol.451, p.163.
- Nika D.L. et. al. Reduction of lattice thermal conductivity in one-dimensional quantum-dot superlattices due to phonon filtering // Phys. Rev. B., 2011, vol. 84, p.165415.
- 9. Weber L. and Gmelin E. Transport properties of silicon // Appl. Phys. A., 1991, vol.53, p.136.
- 10. Ziman J. M. Electrons and Phonons: The Theory of Transport Phenomena in Solids. New York: Oxford University Press, 2001.
- 11. Callaway J. Model for lattice thermal conductivity at low temperatures // Phys. Rev., 1959, vol.113, p.1046.
- 12. Balandin A.A., Pokatilov E.P., Nika D.L. Phonon engineering in hetero- and nanostructures // J. Nanoelect. Optoelect., 2007, vol.2, p.140.
- 13. Pokatilov E.P., Nika D.L., Balandin A.A. Acoustic-phonon propagation in rectangular semiconductor nanowires with elastically dissimilar barriers // Phys. Rev. B., 2005, vol.72, p.113311.
- 14. Nika D.L., Zincenco N.D., Pokatilov E.P. Engineering of Thermal Fluxes in Phonon Mismatched Heterostructures // J. Nanoelect. Optoelect., 2009, vol.4, p.180.
- Pokatilov E.P., Nika D.L., Balandin A. A. Acoustic phonon engineering in coated cylindrical nanowires // Superlatt. Microstruct., 2005, vol.38, p.168.
- 16. Klemens P.G. Thermal Conductivity and Lattice Vibrational Modes // Solid State Physics., 1958, vol.7, p.1.
- 17. Mingo N. Calculation of Si nanowires thermal conductivity using complete phonon dispersion relations // Phys. Rev. B, 2003, vol.68, p.113308.
- 18. Nika D.L., Pokatilov E.P., Askerov A.S. and Balandin A.A. Phonon thermal conduction in graphene: Role of Umklapp and edge roughness scattering // Phys. Rev. B., 2009, vol.79, p.155413.
- 19. Singh D., Murthy J. Y. and Fisher T.S. On the accuracy of classical and long wavelength approximations for phonon transport in graphene // J. Appl. Phys., 2011, vol.110, p.113510.
- Nika D.L., Pokatilov E.P., Balandin A.A. Phonon-engineered mobility enhancement in the acoustically mismatched silicon/diamond transistor channels // Appl. Phys. Lett., 2008, vol.93, p.173111.
- 21. Fonoberov V.A. and Balandin A.A. Giant enhancement of the carrier mobility in silicon nanowires with diamond coatings // Nano Letters., 2006, vol.6, p.2442.

Автор выражает благодарность Академии наук Молдовы за финансовую поддержку проведенных исследований в рамках институционального проекта 11.817.03.10F.

Prezentat la 22.12.2011